

PCT
 WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
 Internationales Büro
 INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)



(51) Internationale Patentklassifikation ⁶: H05K 3/42	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 96/15651 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 23. Mai 1996 (23.05.96)
(21) Internationales Aktenzeichen: ✓ PCT/DE95/01497 (22) Internationales Anmeldedatum: 27. Oktober 1995 (27.10.95) ✓ (30) Prioritätsdaten: ✓ P 44 39 948.0 ✓ 9. November 1994 (09.11.94) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BLAUPUNKT-WERKE GMBH [DE/DE]; Postfach 77 77 77, D-31132 Hildesheim (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BACKASCH, Wolf [DE/DE]; Kiefernweg 3, D-31141 Hildesheim (DE). HOHMANN, Rolf [DE/DE]; Mozartstrasse 6, D-31162 Bad Salzdetfurth (DE). ✓	(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, SG, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht.	

961157-0

(54) Title: METHOD OF PRODUCING A FEEDTHROUGH ON A CIRCUIT BOARD

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DURCHKONTAKTIERUNG AUF EINER LEITERPLATTE

(57) Abstract

The invention proposes a method of producing a feedthrough on a circuit board, the method calling for the circuit board first to be drilled, catalysed and the surface structured. The feedthrough is then built up by electro-deposition in such a way that electrical components can be mounted in the feedthrough. The metallization (7) is preferably carried out using nickel or nickel compounds so that no additional corrosion-protection measures are necessary. By coating connecting lands (2b) with gold or palladium, bonding can be carried out directly on the lands.

(57) Zusammenfassung

Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zur Herstellung einer Durchkontaktierung auf einer Leiterplatte vorgeschlagen, bei dem die Leiterplatte zunächst gebohrt, katalysiert und strukturiert wird. Danach wird in einem elektrochemischen Abscheidungsprozeß die Durchkontaktierung derart aufgebaut, daß die Durchkontaktierung für die Durchsteckmontage von elektrischen Bauelementen nutzbar ist. Die Metallisierung (7) wird vorzugsweise mit Nickel oder Nickelverbindungen durchgeführt, so daß kein zusätzlicher Korrosionsschutz erforderlich ist. Durch Überziehen von Anschlußlands (2b) mit Gold oder Palladium kann direkt auf die Anschlußlands gebondet werden.

